⑷　プラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
ア　溶射前に真空室を10ミリパスカルまで減圧することができるものであって、10キロパスカル以下の圧力（ノズル出口から30センチメートル以内において測定したものをいう。）で使用することができるもの
イ　膜厚制御機能を内部に有しているもの
⑸　スパッタリング法を用いるものであって、毎時15マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が10ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの
⑹　アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの
⑺　イオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの
ア　基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度
イ　基材の表面の光学的特性

44　測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。）又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの（38又は39に該当するものを除く。）
⑴　電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格ＩＳＯ10360／２（2009）で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれの測定点においても、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差（Ｅ０、ＭＰＥ）がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0.001を乗じて得た数値に1.7を加えた数値以下となるもの
⑵　直線上の変位又は角度の変位を測定するためのものであって、次のいずれかに該当するもの
ア　直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　非接触型の測定システムであって、0.2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0.2マイクロメートル以下のもの
(ｲ)　次のいずれかに該当する線形可変差動変圧器（ＬＶＤＴ）を用いた測定システムであって、かつ、19度以上21度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが24時間当たり0.1パーセント以下のもの
ａ　最大の作動範囲がプラスマイナス５ミリメートル以下のものであって、０から最大の作動範囲における直線性が0.1パーセント以下のもの
ｂ　最大の作動範囲がプラスマイナス５ミリメートルを超えるものであって、０からプラスマイナス５ミリメートルにおける直線性が0.1パーセント以下のもの
(ｳ)　次のａからｃまでの全てに該当するもの
ａ　レーザー光を用いて測定することができるもの
ｂ　測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0.2ナノメートル以下のもの
ｃ　測定範囲内のいずれの測定点においても、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のナノメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0.0005を乗じて得た数値に1.6を加えた数値以下のものであって、19.99度以上20.01度以下の温度範囲において30秒を超えて測定できるもの
(ｴ)　(ｳ)に該当するものの部分品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの
イ　角度の変位を測定するもの（平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学器械を除く。）
⑶　光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、0.5ナノメートル以下の感度を有するもの

45　ロボット（⑸から⑺までに該当するものは操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置、エンドエフェクター若しくは部分品（⑸から⑺までに該当するものは別表第１に掲げるもの及びロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。）
⑴　プログラム又はプログラムの数値データを作成又は書き換えるために、即時に完全３次元の画像処理又は完全３次元の情景解析ができるもの
⑵　日本工業規格Ｃ60079―０号で定める防爆構造のもの
⑶　全吸収線量がシリコン換算で5,000グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
⑷　30,000メートルを超える高度で使用するように設計したもの
⑸　軍用に設計したもの
⑹　引火点が566度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの
⑺　電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの

46　フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、測定装置又は工作機械の部分品又は附属装置であるもののうち、次のいずれかに該当するもの
⑴　直線上の位置のフィードバック装置であって、当該装置の精度がミリメートルで表した当該装置の有効測定長さの10万分の６パーセントに0.0008ミリメートルを加えて得た数値未満のもの
⑵　角度のフィードバック装置であって、当該装置の精度が0.00025度未満のもの
⑶　複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械に取り付けることによって、その機械を39又は40のいずれかに規定する仕様にすることができるもの

47　絞りスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、次の⑴及び⑵に該当するもの
⑴　輪郭制御をすることができる軸数が３以上のもの
⑵　ローラの加圧力が60キロニュートンを超えるもの

48　集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの
ア　全吸収線量がシリコン換算で5,000グレイ以上のもの
イ　吸収線量がシリコン換算で１秒間に5,000,000グレイ以上のもの
ウ　１メガ電子ボルト相当の中性子束（積算値）が１平方センチメートルあたり50兆個以上をなるもの（ＭＩＳ型のものを除く。）
⑵　マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの（別表第４に掲げるものを除く。）、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録若しくは解析することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路（⑶から⑸まで若しくは⑺のいずれかに該当する物資であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）別表第１の５から15までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この48において同じ。）、ＦＦＴプロセッサ、プログラムを電気的に消去することができるプログラマブルロム（フラッシュメモリーを含む。）、スタティック式のラム又は磁気抵抗メモリーであって、次のいずれかに該当するもの（民生用の自動車又は鉄道車両に使用する集積回路を除く。）
ア　125度を超える温度で使用することができるように設計したもの
イ　零下55度未満の温度で使用することができるように設計したもの
ウ　零下55度以上125度以下の全ての温度範囲で使用することができるように設計したもの
⑶　信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路であって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　レーザー発振器を有するもの
イ　受光素子を有するもの
ウ　光導波路を有するもの